

# 第 300 回記念講習会

## 日本が製造業で優位性を保つための 最新金型加工技術

開催期日：平成16年 7月15日（木）

申込締切：平成16年 7月 8日（木）

主催：(社)精密工学会

企画：事業部企画第2グループ

協賛：大田区産業振興協会/RP 産業協会/SME 東京支部/応用物理学会/型技術協会/計測自動制御学会/研削砥石工業会/研磨布紙協会/自動車技術会/全日本プラスチック製品工業連合会/素材材センター/ダイヤモンド工業協会/超硬工具協会/電気加工学会/電気学会/電子情報通信学会/砥粒加工学会/日本液晶学会/日本オプトメカトロニクス協会/日本金型工業会/日本機械学会/日本木型工業会/日本金属学会/日本金属プレス工業協会/日本光学学会/日本光学測定機工業会/日本工具工業会/日本工作機器工業会/日本合成樹脂技術協会/日本小型工作機械工業会/日本材料学会/日本セラミックス協会/日本塑性加工学会/日本鍛造協会/日本ダイカスト協会/発明協会東京支部/表面技術協会/プラスチック成形加工学会/レーザ加工学会

国内の金型メーカーは過去に例を見ない転換期を迎えており、生き残るためには画期的な対策を実行することが必要である。その対策の一つとして金型づくりの高度化がある。高度化を実現するには新たな技術へのチャレンジも必要であろうし、従来技術のポリッシュアップももちろん重要になってくる。さらにはグローバル化、ボーダーレスといったトレンドに乗り遅れないために IT 関連技術の導入と上手な使い方も忘れてはならない。高精度な金型を迅速にしかもそれなりの価格で供給する。基本はこれに尽きる。

本講習会では高速・高精度化、高機能化をキーワードに最新の切削、研削、放電加工技術による金型加工技術、金型づくりの最前線についてそれぞれ話題提供していただき、これからのわが国のものづくりが活性化するための技術的指向についてヒントがえられるよう企画しました。

さらに第 300 回記念として、この分野の世界的権威であられる中川威雄東京大名譽教授にこれからの日本の金型技術の展望をアジア諸国の最新情報も含めてお話していただきます。この機会に、講演者との有意義な討論を通して、技術力を深めていただけることを切望します。興味のある皆様には是非奮ってご参加下さい。

日 時：平成16年 7月15日（木） 10時00分～17時00分

会 場：工学院大学 新宿キャンパス 11階 第5会議室（〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2）

\* JR（山手線・中央線・埼京線）、京王線、小田急線、地下鉄（丸の内線・都営新宿線）「新宿駅」下車西口より 徒歩5分

\* 大江戸線 都庁前駅 直結

☆ 会場 URL：<http://www.kogakuin.ac.jp/map/shinjuku/index.html>

司 会：安齋 正博(理化学研究所)、相良 誠(東芝機械株式会社)

次 第

時間	題 目	内 容	講 師
10:00～10:45	ELID 研削による超精密金型加工の現状	電解インプロセスドレッシング研削による超精密加工事例とマイクロファブ리케이션技術の現状を詳解。	理化学研究所 大森素形材工学研究室 大森 整
10:45～11:30	ナノマシニング、電子ビーム PIKA 面加工装置 EBМ	ナノマシニングの特徴とこれを用いた各種加工事例、電子ビーム PIKA 面加工装置 EBМ を用いた各種材料の鏡面加工事例について解説。	ソディック エンジニアリング(株) マイクロ・ナノマシニング責任者 中元 一雄
11:30～12:15	極微細ボールエンドミルによる金型鋼材の高速ミーリング	10 万から 20 万回転のスピンドルを有する高速ミーリング機と極微細ボールエンドミルを用いて金型鋼材を形状加工した際の切削特性について解説。	理化学研究所 先端技術開発支援センター アドバイザー・エンジニアリングチーム 高橋 一郎
12:15～13:15	昼 食		
13:15～14:30	基調講演 わが国の金型産業の現状と将来展望	中国の金型産業の現状とわが国の金型産業の現状を紹介し、わが国の金型産業が優位性を保つためには将来どのように展開していかなければならないかについて言及。	ファインテック (株) 東京大学名誉教授 中川 威雄
14:30～15:15	微細放電加工	亜鉛電極を用いた微細放電加工の特徴とその加工事例について詳解。	大阪府立産業技術総合研究所 機械金属部 増井 清徳
15:15～15:30	休 憩		
15:30～16:15	金属光造形複合加工技術	高速ミーリングとレーザ粉末焼結法を複合化した金属光造形複合加工技術の特徴とこれを用いて製作した家電製品の金型の事例を詳解。	松下電工(株)生産技術研究所 製造システム開発センター 金型システム開発グループ 吉田 徳雄
16:15～17:00	超精密超音波振動金型加工技術	超音波援用切削加工技術、超音波援用コイニング技術の特徴とその加工事例について詳解。	日本工業大学 機械工学科 神 雅彦

定 員：100名（先着順で定員になり次第締切ります）

参 加 費：会員（賛助会員および協賛団体会員を含む）20,000円，非会員30,000円 【会員・非会員ともテキスト代含む】

学生会員 無料（ただし，資料ご入用の場合は，4,000円をご負担ください）

学生非会員 6,000円（テキスト代含む）

\*参加費・テキスト代とも消費税を含みます。

資 料：資料のみ，または聴講者で2冊以上ご希望の場合，1冊4,000円

申込方法：申込書に必要事項をご記入の上，郵送またはFAXにて受け付けます。

申込締切：平成16年7月8日（木）

申 込 先：**(社) 精密工学会**

(〒102-0073 東京都千代田区九段北1-5-9 九段誠和ビル2F，電話 03-5226-5191，Fax 03-5226-5192)

(学会ホームページ <http://www.jspe.or.jp/service/seminar/seminar.html> からも申込出来ます。)